

# iCB 系列

## 自动芯片键合设备

- 六自由度高精度运动台
- 高精度力控制键合头
- 双向镜头上下芯片标记对准
- 多标记对准



### 产品简介

iCB系列产品是星空科技自主研发的自动芯片键合设备，可实现芯片与芯片、芯片与晶圆键合。适用于红外传感器、MicroLED、Chip-Let等应用。具备键合精度高的优点。

### 设备参数

设备型号	iCB500	iCB550	iCB2000	iCB3000	选配
最高温度	350°C				450°C
最高压力	1kN				2kN / 4kN / 10kN
上芯片尺寸大小	1mm~50mm				100mm
下芯片尺寸大小	1mm~50mm		1mm~200mm	1mm~300mm	-
键合后精度	$\leq \pm 1.0\mu\text{m}$	$\leq \pm 0.5\mu\text{m}$	$\leq \pm 1.0 / 0.5\mu\text{m}$		-
上下片模式	手动 / 自动				-

广东星空科技装备有限公司 (集团总部) 广州市增城区塔山大道166号  
智慧星空(上海)工程技术有限公司 (研发中心) 上海市闵行区万芳路515号

☎ +86-(21) 20786666 | +86-18017325886 | +886-972268621

✉ sales@istar-group.com

🌐 <http://www.istar-group.com>



星空科技